

证券代码：000620.SZ

证券简称：盈新发展

上市地：深圳证券交易所



北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

**Winnovation Culturaltainment Development Limited**

**2026 年度向特定对象发行股票**

**募集资金使用可行性分析报告**

**二〇二六年八月**

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金不超过人民币177,931.38万元（含本数）。现公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过177,931.38万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 投资总额       | 拟使用募集资金金额  |
|----|---------------|------------|------------|
| 1  | 先进封测及存储模组制造项目 | 132,066.82 | 105,322.44 |
| 2  | 存储器主控芯片研发项目   | 33,822.94  | 20,608.94  |
| 3  | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 52,000.00  | 52,000.00  |
| 合计 |               | 217,889.76 | 177,931.38 |

本次募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行贷款”的实施主体为公司，“先进封测及存储模组制造项目”及“存储器主控芯片研发项目”的实施主体为公司控股子公司长兴半导体。本次募集资金到账后，“先进封测及存储模组制造项目”、“存储器主控芯片研发项目”拟采取公司向长兴半导体提供借款的方式实施。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

## 二、本次募集资金投资项目的具体情况

### （一）先进封测及存储模组制造项目

## 1、项目概况

本项目通过装修洁净厂房、引进先进的晶圆级封测设备及存储模组自动化生产线，构建集封装、测试与模组制造于一体的智能化生产基地，重点布局NAND FLASH颗粒及DDR5模组制造，以满足公司在服务器、消费电子等领域具备持续的存储产品供应能力，以提升公司在半导体存储器领域的市场地位。

## 2、项目建设的必要性

### （1）优化公司存储产品结构，向高附加值产品应用领域渗透

在企业级、高端半导体存储器市场快速扩容的背景下，通过技术升级实现从消费级市场向企业级及高性能计算市场拓展是公司发展的必然路径。Precedence Research的数据统计显示，2025年，全球数据中心市场的规模约为3,867.1亿美元。预计到2026年，这一数字将上升至4,301.8亿美元；到2035年则将达到约11,037亿美元。2026年至2035年间，该市场的复合年增长率将为11.06%。本项目规划建设DDR5 R-DIMM服务器内存及高堆叠先进封装产能，瞄准了企业级服务器、高端存储产品等对产品性能、稳定性和容量密度有极致要求的应用领域，具有更高的准入门槛和产品附加值。通过掌握的多层堆叠技术并实现DDR5颗粒与模组的规模化生产，公司将能够充分发挥自身在先进封测与DDR5技术领域的技术积累，提升高端产品在营收中的占比。本项目的实施将助力公司通过产能释放占据高端存储市场的核心份额，为知名品牌客户提供高可靠、高性能存储解决方案，进一步提升公司在行业内地位，从而显著增强公司的市场议价权与品牌效应。

### （2）突破现有环节的产能瓶颈，满足下游市场持续增长的交付需求

目前，公司在DDR5服务器存储模组等领域已具备扎实的技术基础与产品开发能力，且相关高新产品已通过部分核心客户的验证。受限于现有生产场地及设备容量的饱和状态，公司高性能存储产品的产销率长期处于高位，产线负荷已接近极限，交付能力的滞后已成为制约公司进一步提升市场份额的核心瓶颈。随着全球半导体产业进入高景气周期，下游整机企业对高端存储部件的采购需求呈现出快速增长的趋势，根据CFM闪存市场分析与预测显示，2025年全球DRAM/NAND Flash市场规模同比增长33%至2,216亿美元；预计到2026年这一规

模将再度突破6,000亿美元，全球存储产业进入高速发展的黄金时代。公司亟需通过本项目建设，引入自动化程度更高的先进封测及模组生产线，实现高性能存储产品的规模化量产。

本项目的实施将显著扩大公司在先进封测和高性能存储模组等产品的供给规模，有效解决现有产能与市场订单需求之间的矛盾，确保公司能够凭借稳定的供货能力嵌入核心客户的供应链体系，稳固公司在存储颗粒及模组领域的市场竞争力。

### （3）加速技术成果的产业化落地，构筑具备市场竞争力的规模化成本优势

半导体存储器行业具有技术迭代快、工艺复杂度高的显著特征，尤其是超高堆叠NAND闪存颗粒以及DDR5颗粒SDP、DDP等存储产品，从实验室研发到大规模量产需经过严苛的工艺验证与良率爬坡。本项目通过建设的先进封测与贴装产线，能够为公司储备的核心封装技术提供专业化的量产承载平台，显著缩短高端存储产品从研发样品到批量上市的产业化周期，确保公司在行业技术红利期内快速抢占市场先机。

同时，高性能存储部件的制造具有显著的规模经济效应，通过本项目形成的规模化生产能力，公司能够实现关键原材料的集中采购及生产资源的集约化配置，形成规模化生产的成本优势，将增强公司的市场价格竞争力，在保持技术领先性的同时，实现经营效益与市场份额的提升，为公司的长期稳健经营奠定坚实的基础。

## 3、项目建设的可行性

### （1）国家及地方高规格产业政策提供外部环境保障

2020年8月，国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8号）明确了国家对集成电路企业的长期扶持力度，针对先进封装及存储器制造领域提供了包括财税优惠、投融资支持、研发支持在内的全方位激励措施。2023年6月，工信部等五部门在《制造业可靠性提升实施意见》中提出提升芯片先进封装材料等电子材料性能分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。2026年3月发布的《中华人民共和国国

民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在第五章“培育壮大新兴产业和未来产业”的框架下，明确提出发展高密度存储器、推进存算一体技术突破应用。地方层面，江苏省政府在《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》中提出构建具有国际竞争力的集成电路产业集群，设立专项资金重点支持先进封装工艺及多芯片异构集成技术的产业化落地。本项目涉及的产品技术路径符合国家对核心电子元器件自主供给能力的规划要求，属于地方政府重点扶持的“链主”企业及高成长性项目范畴，能够获得地方政府在多维度的精准对接与帮助。地方政策的执行细节与项目的建设周期、技术升级方向形成良性互动，为项目投产后的技术迭代与规模化生产提供了实质性的政策保障。

## （2）公司拥有良好的技术储备

公司经过多年在存储芯片封装与测试领域的持续积累，已形成覆盖先进封装、系统级集成、高可靠测试及智能制造等环节的核心技术体系，为本项目实施提供了稳定可靠的技术支撑。公司在存储多Die堆叠封装、存储SiP系统级封装、超薄封装、高速测试及环境可靠性验证等方面均已实现成熟应用，相关技术已通过行业客户验证，并形成规模化量产能力，具备较高的工艺稳定性与产品一致性。与此同时，公司已建立覆盖设计、封装、测试、可靠性验证及智能化生产管理的完整技术平台，能够有效满足高性能、小型化、高可靠存储产品的生产需求，推动高可靠性存储芯片封装测试技术向车规级、工业级应用场景延伸，拓展产品附加值更高的细分市场。当前，公司通过在NAND Flash封测、DDR封测、DRAM模组三大产品线的协同布局，实现从单一NAND Flash封测向“NAND Flash封装封测+DDR封装封测+主控芯片+DRAM模组”的全品类存储封测服务商转型，提升单客户价值贡献和市场覆盖广度。良好的技术储备能够保障项目的顺利实施。

## （3）公司拥有经验丰富的专业团队与成熟的组织管理水平，确保项目顺利施行

公司控股子公司长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，并获得高新技术企业认定，在半导体存储封测领域积累了深厚的行业公信力与技术认可度。同时，长兴半导体构建了涵盖ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001在内的国际标准化管理体系，并持有质量体系注册证书。通过将标准化的治理理念贯穿于产品的

生产制造全过程，公司能够确保在复杂堆叠工艺下产品的性能高度稳定与品质一致，在工艺严谨性维度保障了项目投产后的市场竞争力。

#### （4）广阔的市场空间为项目的新增产能消化提供有力支持

根据多家研究机构统计2025年中国存储芯片市场预计规模突破5,500亿元，且保持年均约20%的增长速率，为新增产能在量级上的消纳提供了客观的行业背景。从供需结构观察，国产存储晶圆全球市占率偏低，2026年一季度，长鑫存储DRAM全球市占率约8%，长江存储3D NAND Flash全球市占率约13%。对照国内各领域海量存储消费需求，本土晶圆供给存在明显结构性缺口，存储产业链自主配套空间广阔。在国家集成电路产业投资基金三期3,440亿元规模的资本引导下，叠加工业和信息化部针对存储领域关键技术节点的政策性布局，本土存储产业链正在经历从单一环节突破向全产业链协同演进的转型。

本项目所涉及的新增产能，正处于供应链国产化比例提升的关键窗口期，能够直接受益于国内存储模组厂商及封装测试环节对于国产化供应安全的需求。下游应用端如高性能计算、数据中心以及智能终端设备对存储容量需求的持续上升，确保了市场增量足以覆盖新增产线投产后的产出释放。

### 4、项目投资估算

本项目总投资132,066.82万元，主要包括装修工程费、设备购置费、设备安装费、预备费、建设期利息和铺底流动资金。

### 5、项目建设期

本项目的建设期为18个月。

#### （二）存储器主控芯片研发项目

##### 1、项目概况

本项目旨在建设一个具备先进水平的存储器主控芯片研发中心，通过引进研发人才、购置先进的软硬件设备，构建完整的芯片设计与验证平台，围绕工业级SSD控制器芯片、工业级EMMC控制器芯片、工业级UFS控制器芯片等系列产品展开研发攻关，打造覆盖芯片设计、固件算法开发、封装测试及模组贴装的完整技术闭环，提高公司存储业务的核心竞争力。

## 2、项目建设的必要性

### （1）掌握核心控制芯片自主研发能力，夯实底层技术护城河

工业级存储器作为半导体存储领域的高端分支，在数据可靠性、环境适应性及使用寿命等方面具有严苛标准。控制器芯片作为存储系统的“大脑”，直接决定了存储产品的核心性能指标及纠错、调控能力，是体现存储企业核心竞争力的底层技术支撑。目前，高端工业级存储控制器市场仍具备较高的技术准入门槛。通过在深圳南山建设研发中心，公司将针对工业级SSD、eMMC及UFS控制器芯片开展深度自主研发，在架构设计、固件算法、纠错技术等领域实现关键技术突破并形成自主知识产权。本项目的实施，将促使公司实现从存储模组集成向核心控制芯片研发的纵向延伸，在夯实底层技术护城河的同时，确保公司能够占据工业级存储产业链的战略制高点。

### （2）优化业务梯度与产品矩阵，实现向高附加值工业级应用领域的深度渗透

随着工业自动化、车载电子及边缘计算等新兴产业的快速发展，市场对具备高稳定性、长周期供应能力的工业级存储产品需求日益旺盛。相较于同质化严重的消费级市场，工业级存储领域具有更高的产品附加值与客户粘性。目前，公司工业级产品在整体营收中的占比仍有较大提升空间。本项目的建设将依托自研控制器的技术优势，开发针对复杂工业环境、极端温度波动及高频振动等复杂场景的差异化存储方案。通过优化产品结构，将业务触角向服务器、数据中心及高端车载存储等领域深度延伸，公司能够有效拓宽盈利空间，实现业务规模与经营质量的协同增长，是公司提升综合竞争力及增强抗风险能力的重要选择。

### （3）集聚集成电路研发人才，完善技术创新体系

高端控制器芯片的开发属于跨学科的精密工程，涉及IC设计、算法开发、固件工程等多个前沿领域，对高素质研发人才的集聚程度有着极高要求。深圳南山作为国内集成电路产业的核心聚集区，具备较强的人才流动优势与产业协同环境。本项目将利用区位优势，招募并培育一批技术专家与核心研发团队。通过配备行业领先的软硬件研发设备及仿真环境，公司将进一步完善技术创新体系。完善的

人才梯队布局与实验条件，不仅能保障本项目研发课题的高质量交付，更能为公司持续的技术创新提供内生动力。因此，本项目的实施对完善公司人才布局、保持技术领先优势具有深远意义。

### 3、项目建设的可行性

#### （1）项目所在地具有成熟的集成电路产业集群与人才储备提供智力支撑

项目拟建地点位于深圳市南山区，该区域作为国内集成电路设计产业的核心聚集地，汇聚了覆盖芯片架构设计、固件算法开发及精密验证等领域的资深专业人才，具备极强的人才吸纳能力与流动优势。南山区完善的产业链配套环境，包括成熟的EDA设计工具供应商、IP授权服务商以及高效的流片代理机构，能够大幅缩短控制器芯片从逻辑设计到样片产出的时间周期。依托区域内高频的技术交流环境与人才溢出效应，公司能够快速组建起研发团队，从而有效降低高端芯片开发过程中的人力成本风险与技术迭代压力，为工业级控制器芯片的高质量交付做好充足的人才铺垫。

#### （2）公司的生产实践经验丰富，确保研发课题顺利进行

公司控股子公司长兴半导体成立于2012年，是国家级专精特新“小巨人”企业，并获得高新技术企业认定，在半导体存储封测领域积累了深厚的行业公信力与技术认可度。同时，长兴半导体构建了涵盖ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001在内的国际标准化管理体系，并持有质量体系注册证书。在长期的生产实践中，长兴半导体针对NAND Flash及DRAM等存储介质的物理特性积累了丰富的实践经验，特别是在高密度封装及先进模组制造领域积累了详实的底层运行数据。依托已有的固件开发经验与产品验证体系，研发团队能够准确模拟工业级应用中极端温度、高频振动及突发断电等复杂场景，确保自研控制器芯片具备可靠性与较强的环境适应能力。

#### （3）公司具有经验丰富的研发团队，确保项目顺利施行

公司拥有深度覆盖存储芯片生产及研发、底层固件开发、硬件设计及系统兼容性验证等核心环节的研发团队，在存储多Die堆叠封装、存储SiP集成化设计以及超薄CSP/BGA封装等维度取得了多项关键技术突破，取得了八十余项专利证



书，为工业级控制器芯片的自主研发构筑了坚实的底层技术屏障。通过科学的职能划分实现了专业技术人才的集约化利用。研发团队在各垂直技术领域通过深度的专业化分工，显著提升了技术攻关的精准度与资源配置效率。依托成熟的技术管理规程与过往产品的量产验证经验，公司建立了标准化的研发产出评价体系，有效降低了研发全生命周期中的技术偏移风险。现有的协作模式与技术管理资产，为本项目在高性能控制芯片领域的攻关提供了稳健的架构支持，能够保障研发课题按照既定周期实现技术突破与成果转化，为本项目的顺利实施提供可靠的组织与制度支撑。

#### 4、项目投资估算

本项目总投资33,822.94万元，主要包括场地租赁费、装修工程费、设备购置费、设备安装费、流片费和研发人员薪酬。

#### 5、项目建设期

本项目的建设期为36个月。

### （三）补充流动资金及偿还银行贷款项目

#### 1、项目概况

本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金52,000.00万元用于补充公司业务发展过程中所需要的流动资金及偿还银行贷款，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。

#### 2、项目必要性分析

最近三年，公司营业收入受宏观经济、行业景气度、市场竞争情况及战略转型等多重因素影响持续下滑。公司当前正大力发展半导体存储器业务，培育公司第二增长曲线。随着公司半导体存储器业务的不断推进，公司经营规模将持续扩大，对营运资金的需求量也将显著增加。未来，随着本次发行募投项目的深入实施，募投项目产能将逐步释放，公司业务规模将进一步扩大，公司经营性现金流将面临一定压力。因此，本次发行将缓解公司营运资金压力，满足公司业务增长需求，有助于公司进一步拓展业务并增强抗风险能力。

### 3、项目可行性分析

本次发行补充流动资金及偿还银行贷款项目符合公司当前实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。同时，公司本次用于补充流动资金及偿还银行贷款的比例未超过本次募集资金总额的30%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规关于募集资金运用的相关规定，方案具备可行性。在募集资金管理方面，公司已按照要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用及管理进行了明确规定。本次发行募集资金到位后将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

### 三、实施能力及资金缺口的解决方式

#### （一）实施能力

##### 1、人员储备

公司已建立完善的人力资源管理与人才培养体系，拥有一支在存储芯片封装测试、模组制造领域经验丰富的管理团队和技术研发团队。核心团队深耕行业多年，熟悉晶圆测试、先进封装、可靠性验证、量产管控及市场拓展全流程，具备较强的技术攻关与项目实施能力。在人才引进、培养、激励及考核方面，公司已形成规范成熟的制度与流程，能够持续吸引芯片设计、封装工艺、测试开发、生产运营等领域专业人才，满足本次募集资金投资项目实施所需的人才保障。

##### 2、技术储备

公司控股子公司长兴半导体始终坚持技术研发与自主创新，拥有省级大容量闪存芯片封测工程技术研究中心等创新平台，长期专注于存储芯片封装测试技术、存储模组解决方案及相关工艺的研发优化与成果产业化。截至2025年底，长兴半导体拥有多项有效专利授权，为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省大容量闪存芯片封装及测试工程技术研究中心依托单位。长兴半导体在高密度封装、高性能测试、高可靠性验证等方面形成了多项核心技术，积累

了丰富的技术成果与工艺经验，能够支撑募投项目产品的研发与量产。长兴半导体持续稳定的研发投入、成熟的技术体系与较强的创新能力，为本次生产基地建设、主控芯片研发等募投项目的顺利实施奠定了坚实技术基础。

### 3、市场储备

经过多年经营与市场拓展，公司控股子公司长兴半导体凭借稳定的产品品质、高效的交付能力及良好的服务口碑，积累了一批优质且稳定的客户资源，在存储芯片封测及模组领域具备较高的市场知名度与客户认可度。丰富的客户储备、良好的品牌口碑以及持续的市场开拓能力，能够为本次募投项目新增产能消化及业务规模提升提供有力保障，有利于项目顺利落地并实现预期效益。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备，能够保证募投项目的顺利实施。

#### （二）资金缺口的解决方式

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以银行贷款、自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

### 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

#### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金用于长兴半导体生产基地建设及深圳研发中心建设，项目实施密切围绕长兴半导体主营业务实施，不涉及业务方向重大调整，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力，募集资金的用途具有合理性、可行性，符合公司及全体股东的利益。

## （二）本次发行对财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时，公司营运资金得到有效补充，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力。

## 五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司整体盈利能力及核心竞争实力，有利于提升公司的影响力，同时可以满足公司日常运营带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此，本次募集资金投资项目具有实施的必要性及可行性，符合公司及全体股东的利益。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年8月17日